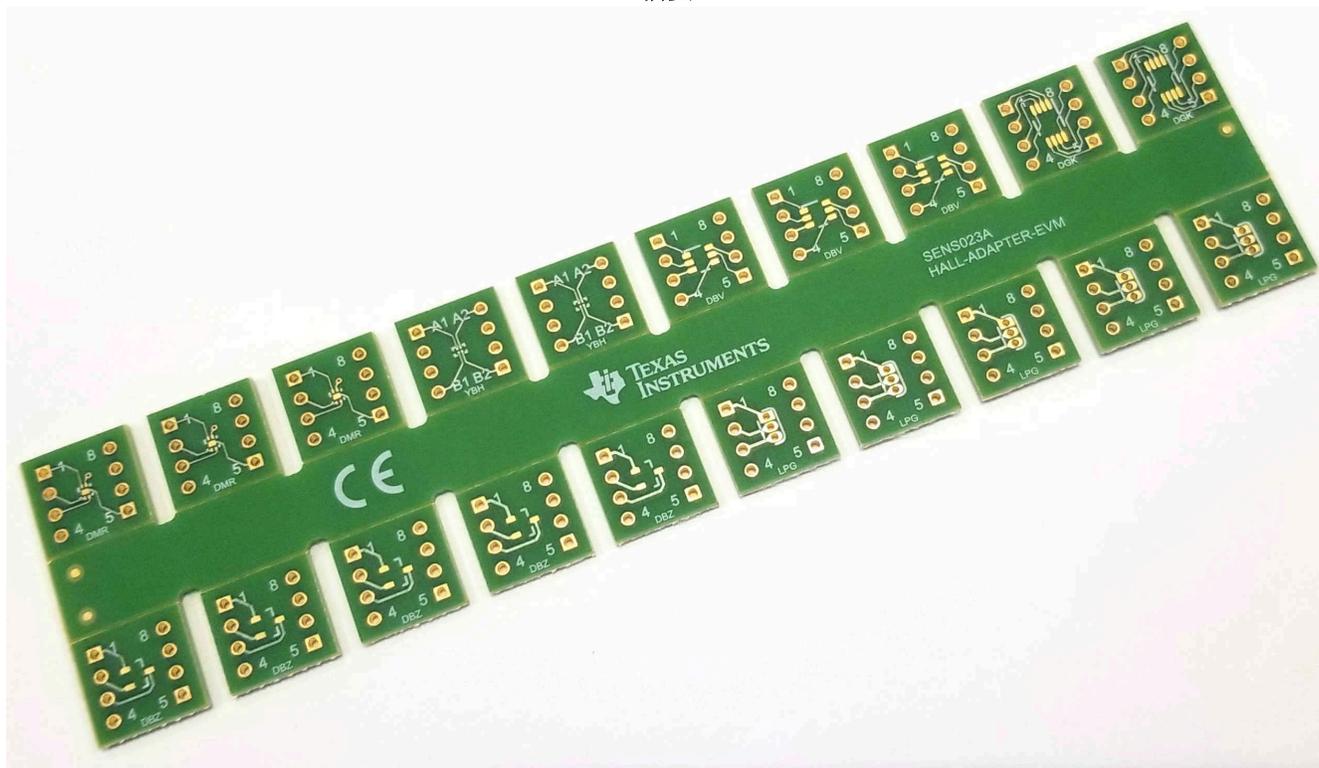


User's Guide
霍尔适配器 EVM

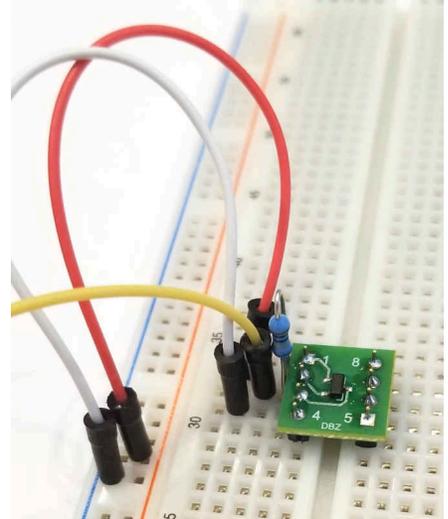


摘要



HALL-ADAPTER-EVM 简化了 SMT IC 原型设计：

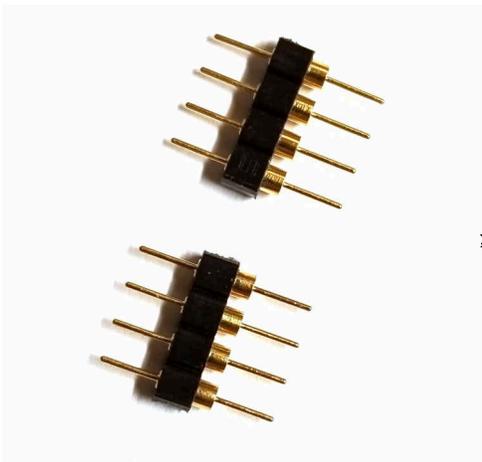
HALL-ADAPTER-EVM 支持 SOT23-3 (DBZ)、TO-92 (LPG)、X2SON (DMR)、SOT23-5/6 (DBV)、DSBGA (YBH) 和 MSOP-8 (DGK) 封装。



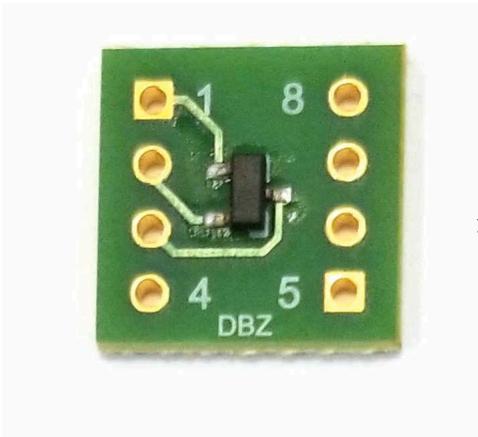
使用说明：



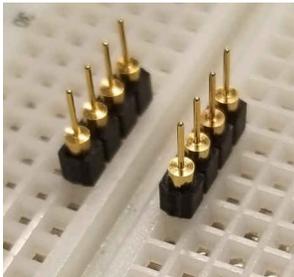
步骤 1：将 IC 焊接至适配器 PCB。还要焊接器件所需的任何必要的去耦电容器。有关合适的去耦电容器值，请参阅器件数据表。IC 可以通过手工焊接，也可以使用 IR 或热气回流技术进行连接。



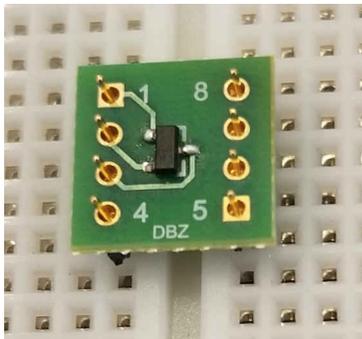
步骤 2：使用长嘴钳将端子条 (Samtec 零件型号 TSW-124-07-L-S) 卡入 4 处位置长度。



步骤 3 : 在划线处轻轻弯曲面板以分离电路板。



步骤 4 : 将端子条插入试验电路板或备用 DIP 插座以对齐引脚。



第 5 步 : 将电路板置于引脚上方，然后焊接连接件。小心地从试验电路板或 DIP 插座上卸下，完成操作。

1 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision B (July 2021) to Revision C (October 2021)	Page
• 更改了 <i>HALL-ADAPTER-EVM</i> 使用说明书中的第 1 步.....	1
Changes from Revision A (April 2020) to Revision B (July 2021)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉引用的编号格式.....	1
Changes from Revision * (November 2017) to Revision A (April 2020)	Page
• 更改了 <i>使用说明书</i> 的格式，以便与其他适配器-EVM 指南格式一致。.....	1

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2022，德州仪器 (TI) 公司